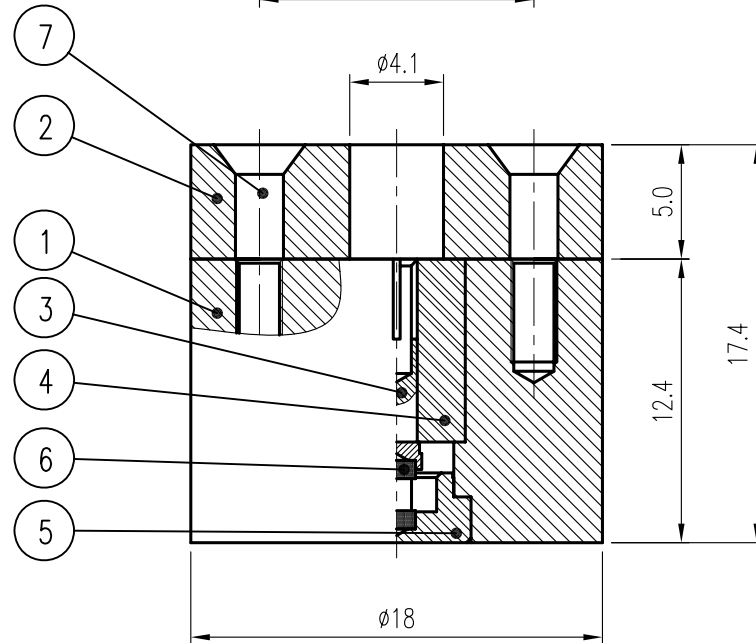
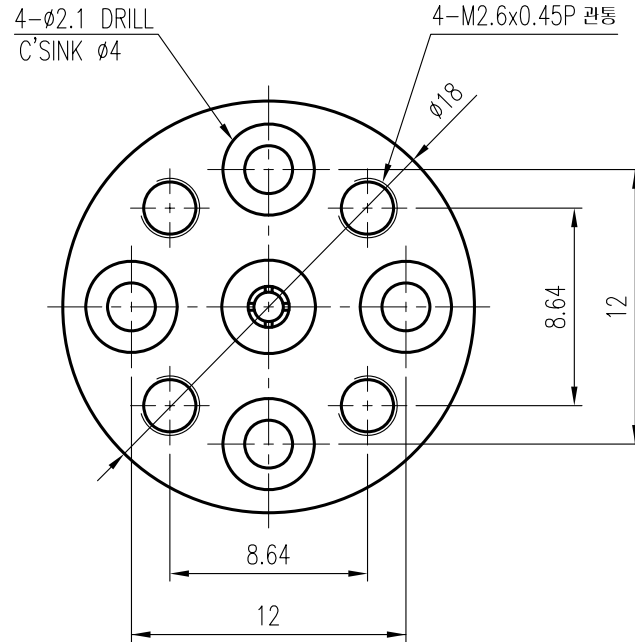


가공	1	2	3	4	수 정 내 용			
ST					부호	내 용	수정자	승인자
ST(기준)					△			년 월 일
ST(개선)					△			



작업지도서

1. BODY①에 INSULATOR⑤를 조립한다.
2. 조립된①BODY에②BODY를 접시머리 나사 M2로 4군데 조립한다.
3. PIN③을 조립한다.
4. 조립된 PIN에 저항⑦을 삽입한다.
5. 조립된 Body와 Cover⑥를 억지 끼움 한다.
6. 멀티미터기로 순수 저항 값을 측정 할 것.
(저항값 : 48Ω ~ 52Ω)

7	M2-8mm 접시머리 BOLT	4	SUS	부동태 처리	DBT00062-N/1
6	RESISTOR	1			DRE00057-N/1 (XA118)
5	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCV00055-5/1
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01400-N/1
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01728-5/1
2	BODY (B)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD02201-5/1
1	BODY (A)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD02199-5/1

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2008. 10. 16.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인					
재질	검도			도명	SMA-P.J-H4-R 측정 내장용 TERM(2W)	
열처리	재도					
보호피막처리	작성부서			A4	도번	TM00031-7/1
	연 구 소					
	적도 5/1	단위 mm	중량			